

Coverage	Media	電子時報	Byline	陳慧玲
	Date			3/28

## 台灣電子業整併新創舉！ 世平 品佳合組控股公司 大聯大控股營收規模破千億 踏上挑戰全球第一之路

在近來台灣電子業整併傳言四起的氛圍中，當大部份人都還在不斷猜想揣測大吃小、大併小等等不同可能時，由台灣 IC 通路產業所引發的新一波整併大動作，卻在此時拋出了完全不同的整併思考方向。由台灣第一大 IC 通路商世平興業與台灣第三大通路商品佳公司，宣佈將以換股合組投資控股公司，以仿效金控集團的運作模式，創造出台灣電子業第一家整併成立的投資控股公司。

而此家被命名為大聯大投資控股股份有限公司的新公司，其旗下所擁有的世平、品佳、以及由世平持股 70% 的富威科技，以去年營收估計，則該控股公司營收規模將達到新台幣 1,100 億元，總資產規模超過 350 億元，員工人數則高達 2,400 人，在亞太市場所設立的據點更超過 50 處，不但穩坐亞太地區第一大 IC 通路商，就整體亞太半導體通路商市場來看，其佔有率也將有機會突破 10%，足以正面迎戰由歐、美挾勢而來的 Arrow、Avnet 等全球 IC 通路強龍。

身為亞太、台灣區 IC 通路商龍頭的世平興業，以及台灣第三大 IC 通路商品佳公司，27 日分別召開董事會，會中討論通過將以股份轉換的型式，共組設立大聯大投資控股股份有限公司。未來世平與品佳將成為大聯大投資控股旗下的子公司，2 家公司仍將存續正常運作，但目前在台灣掛牌上市的世平、品佳股票，則都將因與大聯大投資控股換股而下市，所有持有世平、品佳股票的投資人，則將全數轉換持有新上市控股公司大聯大投資控股的股票。

而根據目前世平、品佳共同決議的規畫，世平將以每 1 股世平股票換發大聯大 1.18 股股票，而品佳則是以 1 股換 1 股的模式，換發控股公司大聯大的股票。新成立的大聯大投資控股公司資本額將為 67.11 億，世平與品佳將於 6 月 14 日召開股東常會討論換股合組投資控股公司議案，暫訂股份轉換與新設公司上市基準日為 9 月 1 日。

世平表示，此次與品佳合組投資控股公司籌畫已有半年時間，未來在雙方既有已佈建之行銷網路、完整代理線基礎上，透過大聯大投資控股所提供的完整後勤支援平台整合效益，除可為客戶提供更高滿意的服務外，另一方面也仍兼顧到目前雙方公司獨立經營的彈性需求。